

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年5月30日(30.05.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/111656 A1

(51) 国際特許分類:
C08F 26/00 (2006.01) C07D 207/412 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/042116

(22) 国際出願日: 2023年11月24日(24.11.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-187894 2022年11月25日(25.11.2022) JP

(71) 出願人: 日本化薬株式会社(NIPPON KAYAKU
KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1000005 東京
都千代田区丸の内二丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 遠島 隆行 (TOHJIMA Takayuki);
〒1158588 東京都北区志茂3-3-1-12 日本
化薬株式会社 機能化学品研究所内 Tokyo
(JP). 窪木 健一(KUBOKI Kenichi); 〒1158588
東京都北区志茂3-3-1-12 日本化薬株式
会社 機能化学品研究所内 Tokyo (JP). 橋本
昌典(HASHIMOTO Masanori); 〒1158588 東京
都北区志茂3-3-1-12 日本化薬株式会
社 機能化学品研究所内 Tokyo (JP). 中西 政
隆(NAKANISHI Masataka); 〒1158588 東京
都北区志茂3-3-1-12 日本化薬株式会
社 機能化学品研究所内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 三上 葉子(MIKAMI Yoko); 〒3300854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-2-6
6-3 JC特許事務所 Saitama (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

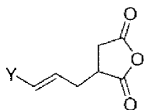
(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: COMPOUND, CURABLE RESIN COMPOSITION AND CURED PRODUCT THEREOF

(54) 発明の名称: 化合物、硬化性樹脂組成物およびその硬化物



(57) Abstract: The present invention provides a compound having excellent heat resistance and low dielectric properties, and a curable resin composition and a cured (a) product thereof. The compound is obtained by reacting a compound represented by formula (a) with a compound having two or more amino groups per molecule. (In formula (a), Y represents a C1-20 hydrocarbon group.)

(57) 要約: 本発明は、耐熱性、低誘電特性に優れる化合物、および硬化性樹脂組成物及びその硬化物を提供する。下記式(a)で表される化合物と、分子内に2つ以上アミノ基を有する化合物と、を反応させて得られる化合物。(上記式(a)中、Yは炭素数1~20の炭化水素基を表す。)

WO 2024/111656 A1